

成都振芯科技股份有限公司 关于签署《保证合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，具体内容详见公司于2023年8月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告（公告编号：2023-055）。

二、保证合同的主要内容

公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）签署完成编号为“2023信银蓉东湖最高保字第317149号”的《最高额保证合同》，主要内容如下：

1、保证方式：连带责任保证。

2、被担保的主债权：中信银行与国翼电子在2023年10月24日至2024年10月24日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

3、最高额限度：3,000万元。

4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的1.96%。截至本公告日，公司已审批对子公司担保额度为9,000万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的5.89%，全部为公司对子公司的担保。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、《最高额保证合同》。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日